



BOITIER μ ATX
Y777-3

Boitier à encombrement réduit
pour carte mère de format micro-ATX



SPÉCIFICATIONS

Type de boîtier	Horizontal à encombrement réduit
Format de la carte mère	Micro ATX (244 x 244 mm - 9,6" x 9,6")
Baies de disques	1 de 5,25" externe, sans outil 1 de 3,5" externe/interne, sans outil 1 de 2,5" interne, sans outil
Bloc d'alimentation	TFX 12 V 300 W 80+ Gold
Fentes d'expansion	4 fentes PCI, hauteur réduite, sans outil
Dimensions (L x H x P)	338 mm x 102 mm x 356 mm - 12,27 litres
Poids net	2,94 kg sans le bloc d'alimentation



CARACTÉRISTIQUES

Matériaux

Recyclables, conforme à RoHS
ABS, feuille d'acier SGCC de 0,6 mm

Commandes et prises en façade

Commutateur d'alimentation
DEL d'alimentation et DEL du disque dur
2 ports USB 3.2 gén. 1 (1 type A et 1 type C)
2 ports USB 2.0
2 prises audio HD

Ventilateur

60 mm en façade

Autres caractéristiques

Peut être installé à la verticale ou à l'horizontale
Bouton de dégagement rapide du couvercle
Accès facile aux baies de disques par un bouton de dégagement rapide
Glissières sans outil pour les disques durs et lecteur optique sans vis supplémentaires

Sécurité

Détecteur d'intrusion
Fente Kensington
Anneau pour câble de sécurité ou cadenas empêchant l'ouverture du boîtier

Émissions

Conforme à la norme FCC classe B

